



T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI



Savunma Sanayii Akademi (SSA)

“Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi Temel Seviye Eğitimi

-Genel Bilgilendirme-

Birçok endüstriyel uygulama için son derece kritik bir proses olan “Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi günümüzde farklı imalat ve üretim alanlarında vazgeçilmez bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi, en basit ev aletleri/araçları ve kişisel ürünlerden yüksek hassasiyet gerektiren makine mühendisliği, havacılık ve uzay uygulamalarına kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan temel bir prosestir.

Sızdırmazlık teknolojisi, kaplama teknolojisi, termal genleşme/stres yönetimi, kütleme kimyası ve konstrüktif tasarım gibi birçok alanı içinde barındırması nedeniyle multidisipliner bir proses olan “Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi metal-metal, metal-polimer, metal-kompozit, metal-cam, polimer-polimer, kompozit-kompozit, cam-polimer, cam-metal, kauçuk-metal, kauçuk-kauçuk, vb. birleştirme proseslerinde etkin olarak kullanılabilmektedir.

Savunma Sanayii’nde alüminyum ve titanyum gövde elemanları, çelik bazlı yapısal, balistik koruma sistemleri, zırh sistemleri, zırh-gövde bağlantıları, kompozit-metal bağlantılar, devre kartları (PCB), “flip-chip bonding” vb. uygulamalar için; **uzay/havacılık sektöründe** alüminyum gövde ve yapısal, metal-seramik bağlantılar, “CFRP” (Karbon Takviyeli Polimer Kompozit)-metal bağlantılar, radom-gövde bağlantıları, termal ve kriyojenik izolasyon, “booster” yapısal, vb. uygulamalar için “Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara “Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi alanında yetkinlik kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Savunma Sanayii Akademi (SSA) bünyesinde 06.12.2021-10.12.2021 tarihlerinde “Bonding/Yapıştırma” Teknolojisi Temel Seviye Eğitimi verilecektir. Eğitim, SSA adına TR Eğitim ve Teknoloji (TET) A.Ş. tarafından çevrim içi olarak yürütülecek olup, eğitimin kapsamı ve diğer teknik detaylar ekteki “Ek-3 BNTS Bilgi Notu” nda sunulmuştur.